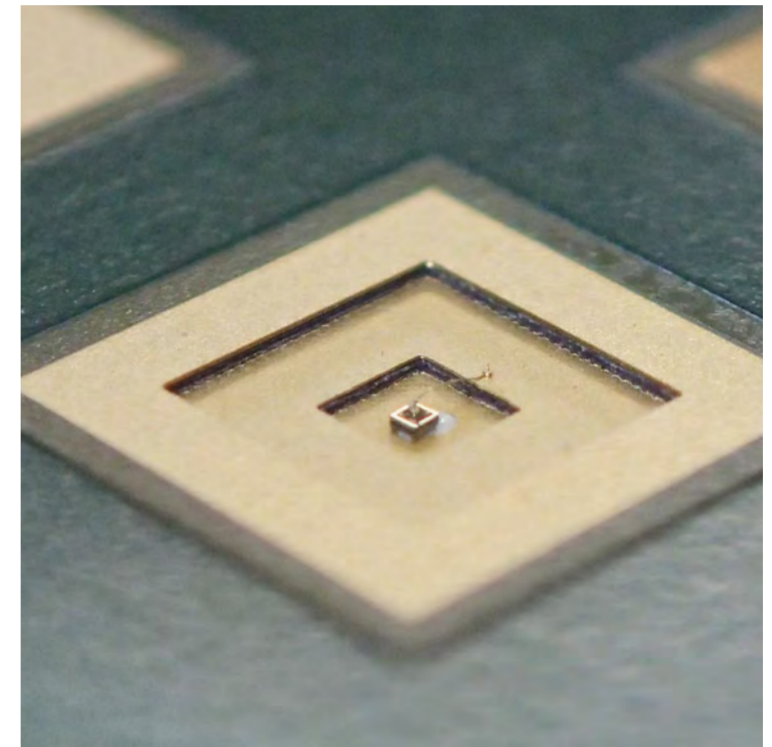
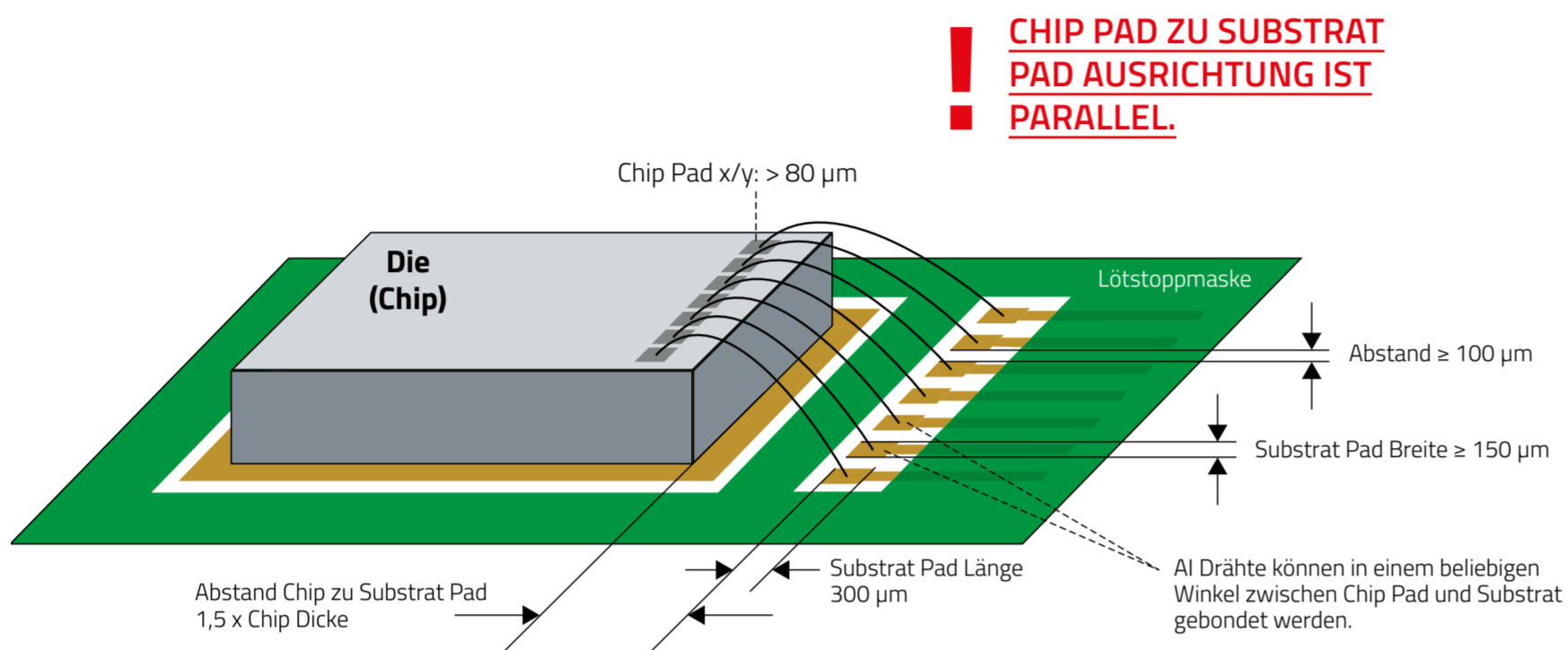


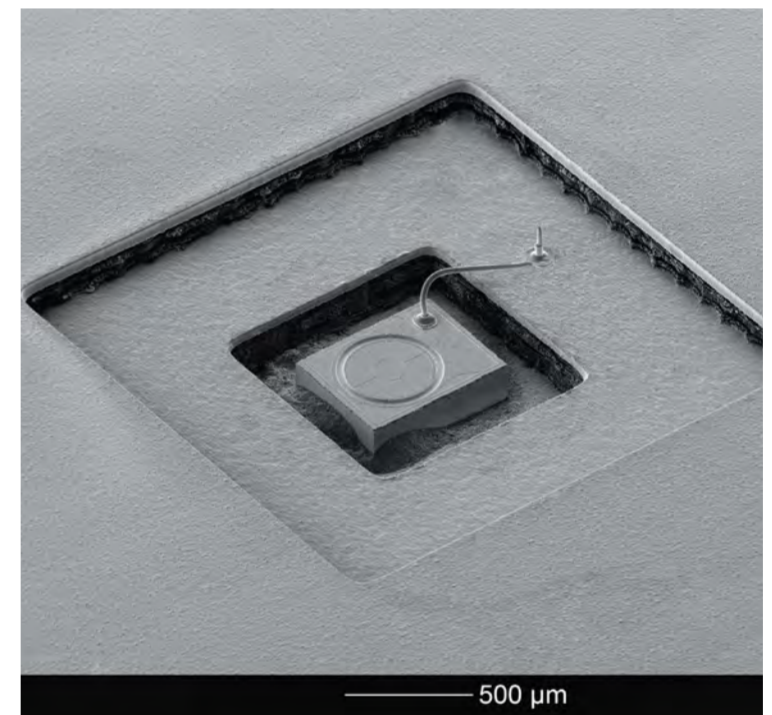
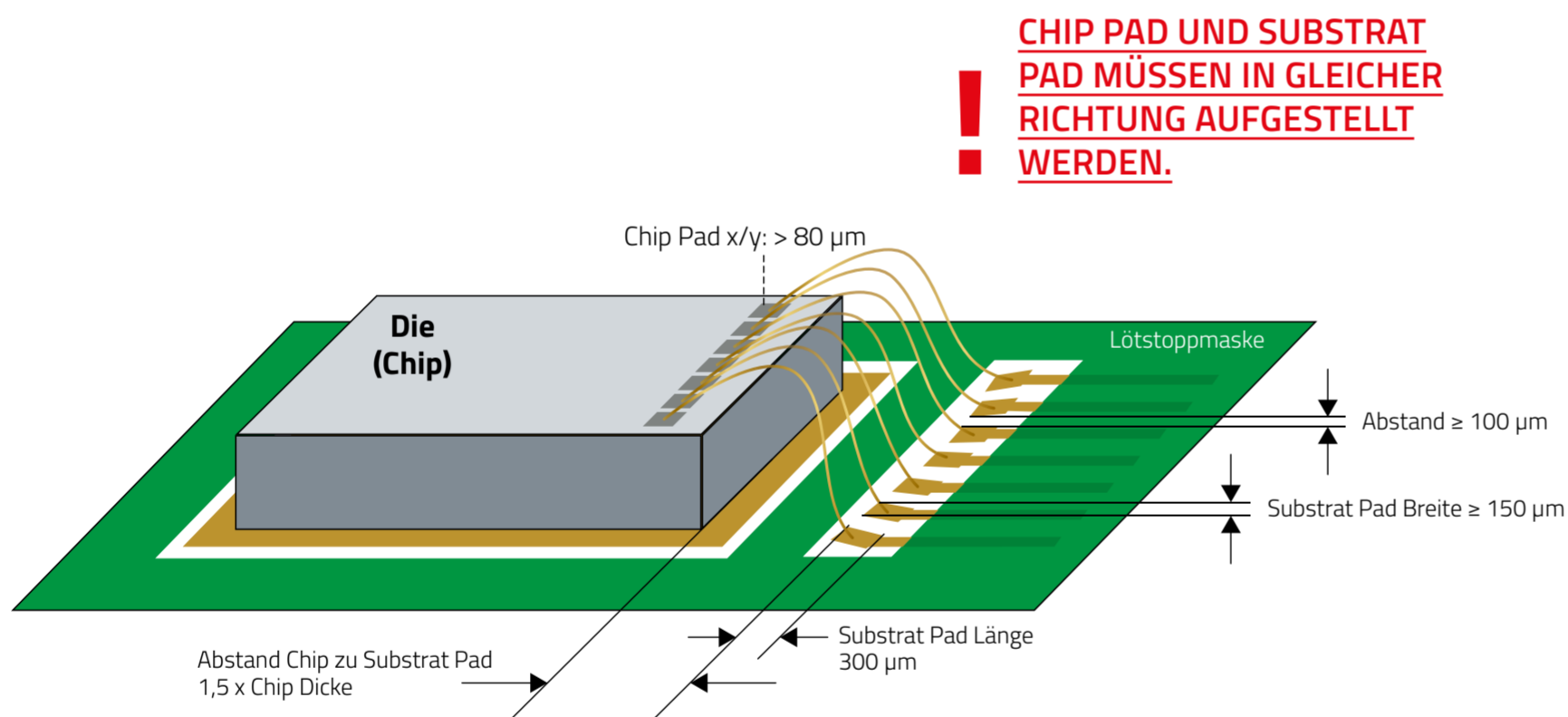
# CHIP ON BOARD / DRAHTBONDEN

## Designregeln für Aluminium (Al) Drahtbonden



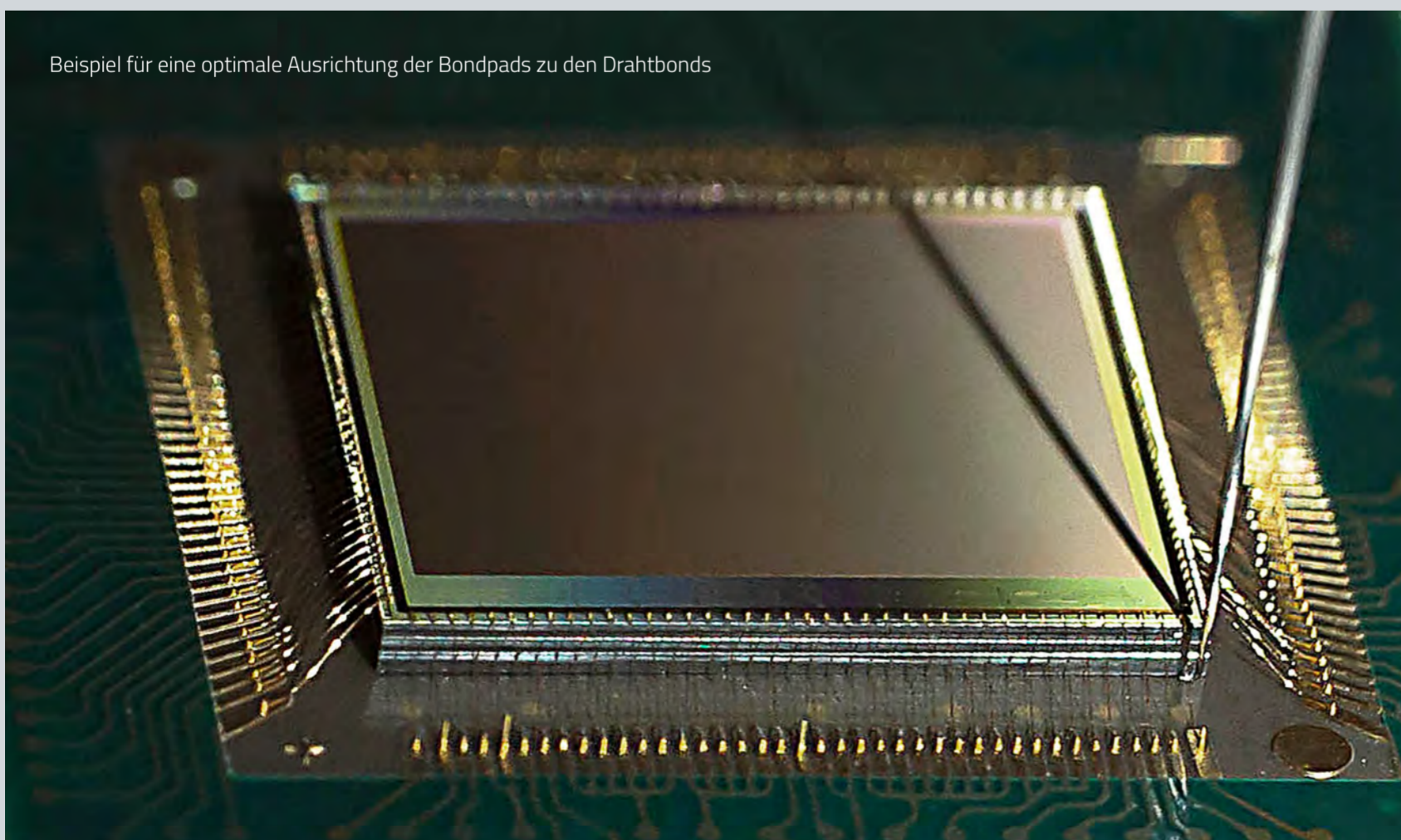
Drahtgebondete Diode in einer mehrstufigen Lasercavity

## Designregeln für Gold (Au) Drahtbonden



REM-Vergrößerung einer drahtgebondeten Diode in mehrstufiger Lasercavity

Beispiel für eine optimale Ausrichtung der Bondpads zu den Drahtbonds



**! IM BEREICH DER DRAHTBONDPADS MUSS DIE LÖTSTOPPMASKE IM BLOCK FREIGESTELLT WERDEN!**

**MORE SUPPORT THAN YOU EXPECT**

[wirebonding@we-online.com](mailto:wirebonding@we-online.com)

Sie haben Fragen zu Fertigungsdaten, Toleranzen, Prüfdokumentation oder Verpackung? In unserer Technischen Lieferspezifikation für Leiterplatten (TLS) finden Sie unsere Standards und Empfehlungen für eine reibungslose und effektive Zusammenarbeit.